

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

**深圳市英唐智能控制股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	不特定投资者
时间	2021-5-11 15:30-17:00
地点	全景·路演天下（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：胡庆周 董事会秘书：刘林 财务总监：许春山 独立董事：高海军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（本投资者关系活动记录表中涉及的未来经营计划、预测是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及判断，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。）</p> <p>深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日（星期二）15:30-17:00在全景网举办了2020年度业绩网上说明会，本次业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p><b>问题 1：各位领导，首先预祝公司产业转型成功，后期公司完成转型后，其业务将对标国内那些半导体上市公司呢？谢谢。</b></p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和支持，公司目前正在向具有半导体研发、制造及销售全产业链条的 IDM 企业转型，车载 IC 及功率半导体器件是重点发展方向，待相关转型完成后，可对标国内相同产品类型的半导体 IDM 企业。谢谢。</p> <p><b>问题 2：请问公司是否有增发股份募集资金的意向？</b></p>

回复：尊敬的投资者，您好！如公司后续有增发股份募集资金的计划，公司将及时通过证监会指定信息披露媒体对外披露，敬请留意公司公告，感谢您对公司的关注。

**问题 3：英唐智控现在的主业是芯片设计和芯片分销，智能控制业务占比已经非常小了。为什么不更换公司名称，更好的反应贵司的业务和愿景？**

回复：感谢这位投资者朋友对公司的关注！这个好的建议我已经跟董事长及其他董事进行反馈。我们正在一步一个脚印的实现公司战略目标，为投资者带来更多的价值会是更实惠的，而不仅仅是改个名字。公司将根据业务发展情况综合考虑，如有相关计划将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**问题 4：之前公司不是说收购芯石完成后就建生产线吗？怎么拖到现在还没有着落，恐怕到时黄花菜都凉了。**

回复：投资者您好！半导体芯片行业是对研发技术、生产工艺、产品验证要求极高的行业，建立工厂需要做好充分的前期准备，公司正在努力推动相关工作的进展。目前，公司一方面正在通过日本英唐微技术的产线运营积累经验，培训人员；另一方面公司计划后续引入包括政府、战略投资者在内的合作伙伴，为产线建设寻求土地、资金及技术等条件支持，相关事项公司将严格按照深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务。

**问题 5：目前公司都有哪些客户，以及哪些产品？**

回复：尊敬的投资者，在电子分销领域，公司业务覆盖 PC/服务器、手机、家电、公共设施、汽车、工业等多个行业，积累了诸如飞利浦、比亚迪、小米、OPPO\VIVO、格力、美的及海康威视等丰富的客户资源。子公司英唐微技术产品主要包括光电传感器和车载 IC，经过多年的积累，英唐微技术向包括爱普生、丰田、本田、尼桑、大发等在内的日本公司供应产品，谢谢。

**问题 6：十大股东里机构私募寥寥无几，是否机构都不看好贵公**

司？

回复：感谢您对公司的关注！种好梧桐树，不怕引不来金凤凰！

**问题 7：请问胡董：进口品牌的 IC 今年来价格涨幅巨大，贵司分销业务从中受益，请问去年年末进口品牌 IC 存货积压多吗？**

回复：尊敬的投资者，公司去年年末的 IC 存货保持在正常水平，谢谢。

**问题 8：请问：（1）斥巨资收购日本公司量产如何，有在中国国内生产销售计划吗？（2）收购上海芯石未来两三年对公司业绩贡献如何？面临目前汽车芯片短缺现状，是否可以集中精力于汽车芯片研发生产？**

回复：尊敬的投资者，您好！日本子公司英唐微目前生产经营稳定，其 2021 年一季度实现营业收入 10,483.58 万元，较上年同期增长 23.64%，占公司当期营业收入的 6.74%；实现净利润 1,671.27 万元，较上年同期增长 459.06%。目前公司正在帮助英唐微技术开拓国内市场，以便扩大其经营规模。目前英唐微技术的车载 IC 和上海芯石的功率半导体器件均可应用于汽车领域，汽车芯片作为公司产品研发的重要方向，公司将提供充分资金和研发资源，积极推动相关产品的研发升级及推广销售，感谢您对公司的关注！

**问题 9：英唐微和上海芯石属于公司的分公司还是子公司？**

回复：尊敬的投资者，您好，英唐微技术与上海芯石均为公司控股的子公司，纳入公司合并报表范围。感谢您的关注！

**问题 10：英唐微的生产线改造大半年了，现在是什么情况？另外公司收购上海芯石后，建厂计划怎样落实？**

回复：尊敬的投资者，您好！自 2020 年 12 月份以来，公司部分核心团队人员一直留驻英唐微技术，积极推动英唐微技术的深化整合和第三代半导体产品线改造，但受到全球范围的半导体产能紧张影响，上游半导体关键设备供应紧张，英唐微技术产品线改造进展不及预期。半导体芯片行业是对研发技术、生产工艺、产品验证要求极高的行业，建立工厂需要做好充分的前期准备，公司正在努

力推动相关工作的进展。目前，公司一方面正在通过日本英唐微技术的产线运营积累经营，培训人员；另一方面计划引入包括政府、战略投资者在内的合作伙伴，为后期的产线建设寻求土地、资金及技术等条件支持。相关事项公司将严格按照深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

**问题 11：胡董你好，公司的转型不仅方向正确，而且实施也很成功，都按计划脚踏实地地展开。我想问一下，日本子公司的芯片目前是否满负荷生产，产供销都不成问题？今年能给公司带来多少效益？公司是否有再增加产能的打算？再问一下，据说芯片生产上美日会联手，这会对公司带来什么不利影响？谢谢。**

回复：感谢您的关注。我们始终稳扎稳打，逐步实施我们的战略规划。日本公司并入公司后，我们协调资源，业务和市场等多方支持，业务稳步上升，目前接近满负荷，产供销等尚能满足。具体效益，请及时关注季报。公司有继续扩产等规划，具体请及时关注公告。谢谢。

**问题 12：公司现在有芯片成品销售吗？销售额有多少？**

回复：有，目前在日本和国内均已实现英唐品牌的成品销售，具体金额请关注年报。感谢您的关注。

**问题 13：说明英唐微的业务收入状况？**

回复：感谢您的关注，英唐微技术的收入稳步改善中。

**问题 14：请问董秘：贵公司和华为的合作是在哪方面的？**

回复：感谢这位投资者朋友的关注，我们没有直接向华为供货，而是有些模组厂会使用我们的元器件。

**问题 15：你好，请问有引入国资背景或实力雄厚的战略性投资者计划吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！为达到 IDM 自主可控的目标，公司规划在未来建立自己的配套工厂，以满足自给需求。由于建厂投资具有一定规模，且建设周期较长、前期投入较大，公司不排除酌情考虑引入政府投资或其他战略投资者。如公司后续计划引入战略

投资者，公司将及时通过证监会指定信息披露媒体对外披露，感谢您的关注。

**问题 16：请问今年业绩预测如何？**

回复：感谢您的关注！关于业绩情况请留意公司在监管法定平台的定期报告关于财务报告部分。

**问题 17：上海芯石盈利吗，2020 年营业收入是多少？**

回复：尊敬的投资者，上海芯石近年来一直保持盈利，其 2020 年的营业收入同比也呈现增长趋势，谢谢。

**问题 18：建议公司主动与华为联系，强强联合，做大做强，占领国内市场。**

回复：尊敬的投资者，您好，在向半导体芯片领域转型的道路上，英唐绝不是单打独斗就能成功的，我们要团结一切可以团结的力量，充分调动各种资源，同各方合作伙伴一起实现互利共赢，感谢您对公司的宝贵建议！

**问题 19：请问目前英唐微能生产国内汽车的芯片吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前公司核心团队已在日本子公司英唐微技术的现场对其现有技术、业务等方面进行全面梳理整合，以加快推动公司对其生产线的升级改造及其产品、技术与国内市场的对接进程。感谢您对公司的关注！

**问题 20：上海芯石一季度业绩如何？有并表吗？**

回复：感谢您的关注，上海芯石从 2021 年 5 月开始并表。

**问题 21：请问公司后续有无意向通过并购整合的方式与各领域国产芯片龙头开展更深入的合作？**

回复：感谢您的关注。目前公司会在合适情况下参与国产芯片细分领域龙头企业的投资并开展分销代理的合作。

**问题 22：为什么公司股价反应不出公司前景？**

回复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价的短期波动受到经济环境、行业趋势、市场情绪等多种因素的综合影响，目前，公司经营基本面稳定，向半导体芯片领域转型升级的各项布局正在逐一

落地实施。公司将努力做好经营工作，继续布局强化半导体芯片产业链，为投资者创造长期可持续的投资价值，感谢您对公司的关注！

**问题 23：上海芯石没有计划在科创板上市？**

回复：尊敬的投资者，您好！上海芯石暂无科创板上市的计划，目前芯石还处于成长期，在发展到一定阶段公司不排除会进行适当的运作。如有相关计划，公司将及时履行信息披露义务，请您关注公司的相关公告，谢谢。

**问题 24：日本生产线改造现在是什么进展？**

回复：感谢这位投资者朋友对公司的关注！自 2020 年 12 月份以来，公司部分核心团队人员一直留驻英唐微技术，积极推动英唐微技术的深化整合和第三代半导体产品线改造，但受到全球范围的半导体产能紧张影响，上游半导体关键设备供应紧张，英唐微技术产品线改造进展不及预期。公司将持续通过包括产品线改造、收购或自建的方式来帮助公司获得相应的生产制造能力。

**问题 25：原大股东深赛格在 2020 年 10 月 23 日公告减持计划完毕，为何在在公告新的减持计划就在 12 月 30 日前清仓式减持了二千多万股？能否解释一下？**

回复：尊敬的投资者，您好！赛格集团在 2020 年 9 月 8 日首次减持股份导致其持股比例下降至 5% 以下的三个月后，即 2020 年 12 月 8 日以后其股份减持根据《关于就深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则有关事项答投资者问（二）》规定，可不再向上市公司通报其减持的具体情况并进行披露，感谢您对公司的关注！

**问题 26：（1）请问胡庆周先生，日本英唐微生产线的改造，受疫情影响进展情况？具体估计还要多久？（2）公司建厂是不是在二，三年后？（3）美日对我国半导体的技术封所，对公司以后产品的影响？**

回复：投资者您好，自 2020 年 12 月份以来，公司部分核心团队人员一直留驻英唐微技术，积极推动英唐微技术的深化整合和第

三代半导体产品线改造，但受到全球范围的半导体产能紧张影响，上游半导体关键设备供应紧张，英唐微技术产品线改造进展不及预期。公司将持续通过包括产品线改造、收购或自建的方式来帮助公司增强在生产制造能力方面的布局，公司计划在 2-3 年内实现自有工厂的建成投产，谢谢。

**问题 27：请问贵司近年来有何具体规划及未来公司的定位，谢谢！**

回复：公司将以前具备的半导体芯片研发、制造能力为基础，继续加大在半导体芯片制造、封装领域的产业布局，并最终形成以电子元器件渠道分销为基础，半导体设计与制造为核心，集研发、制造及销售为一体的全产业链半导体 IDM 企业集团。为抓住历史机遇，加快实现公司打造半导体芯片研发、制造及销售的全产业链 IDM 企业的战略目标，2021 年公司重点工作为：抓住国产替代的窗口期，确保华商龙体系电子元器件分销业务稳定发展；推进现有半导体业务的深化整合；持续布局半导体产业，增厚增强公司的研发制造能力。感谢您的关注。

**问题 28：在中美关系紧张背景下，日美欲在半导体等关键领域打造脱离中国的产业链的背景下，请问公司，对此形势英唐微作为中资控股的企业，有哪些优势和挑战，后续将如何取长补短？**

回复：公司作为贴近国内上下游市场的本土分销商，较国外分销商天然具备物流效率、资源配置效率与沟通效率方面的优势，以及目前公司半导体产业布局已逐步展开，并初步形成了研发、制造、销售的全产业链条。但是半导体芯片行业是对研发技术、生产工艺、产品验证要求极高的行业，公司转型半导体企业需要一定的时间周期。为抓住历史机遇，加快实现公司打造半导体芯片研发、制造及销售的全产业链 IDM 企业的战略目标，公司将推进现有半导体业务的深化整合，持续布局半导体产业，增厚增强公司的研发制造能力作为公司 2021 年的重点工作。具体内容您可查看公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》第四节“九 公司未

来发展的展望”的相关内容。感谢您的关注！

**问题 29：请问贵公司英唐微在日本可以生产国内汽车的芯片吗？有可能将生产线移回中国吗？**

回复：目前公司子公司英唐微技术在车载领域产品主要包括数字电视信号接收 IC、BUS-IC、汽车诊断 IC（GNSS 和 V2X 系统线路连接状态检测）以及其他器件产品等。目前公司核心团队已在日本子公司英唐微技术的现场对其现有技术、业务等方面进行全面梳理整合，以加快推动公司对其生产线的升级改造及其产品、技术与国内市场的对接进程。感谢您对公司的关注。

**问题 30：（1）英唐微改造生产线什么时候能完成？（2）英唐微第一季度的利润是多少？**

回复：一季度英唐微技术实现营业收入 10,483.58 万元，较上年同期增长 23.64%，占公司当期营业收入的 6.74%；实现净利润 1,671.27 万元，较上年同期增长 459.06%。目前公司团队人员仍在日本，推动英唐微技术生产线的升级改造进程，相关升级工作仍需要一定时间。英唐微技术产品线改造进展不及预期是因为受到全球范围的半导体产能紧张影响，上游半导体关键设备供应紧张。围绕第三代半导体器件产品持续开展产业布局是公司自 2019 年以来明确的战略方向，为此，为确保公司战略转型顺利实施，公司拟采取包括产品线改造、收购或自建的方式来帮助公司获得相应的生产制造能力，后续情况进展敬请留意公司公告，感谢您对公司的关注。

**问题 31：你好，领导们，看互动平台说上海芯石 IGBT 是未来推广开发的主要产品，问 IGBT 产品是已有还是处于正在研发？谢谢**

回复：投资者您好！IGBT 产品是上海芯石的重点发展方向，目前正处在样品的工程验证阶段，待相关验证工作完成后，即可开展市场推广工作，谢谢。

**问题 32：第三代半导体目前主要产品是什么？**

回复：投资者您好！公司控股子公司上海芯石拥有十几年的半导体功率器件研发经验，产品覆盖 Si 基、SiC 基领域。在 SiC 功率



	<p>器件领域，上海芯石已经成功开发了 600V、1200V、1700V、3300V 的 SiC-SBD 产品，而当前市场主流产品集中在 1700V 以下，超过 1700V 的本土功率器件并不多见，目前 SiC-SBD 产品的部分型号已经实现了批量销售，除此之外上海芯石也正在进行 SiC-MOSFET 产品的开发，感谢您对公司的关注。</p> <p><b>问题 33：请问：日本子公司所研发的 MEMS 振镜产品，是自动驾驶所用激光雷达的模组之一。这模块国内企业有订单吗？</b></p> <p>回复：投资者您好！目前日本子公司英唐微技术的 MEMS 振镜产品主要向日本境内的客户进行销售，后期公司也将逐步开拓相关领域的国内市场，感谢您对公司的关注！</p> <p>问答沟通过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 5 月 11 日